**专业培训记录**

**□QMS** **■EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **研创光电科技(赣州)有限公司** | | | **专业小类/**  **项目代码** | **19.01.02** |
| **教师姓名** | | **文波** | **专业** | **19.01.02** | **培训地点** |  |
| **受培训人员** | **姓名** | **伍光华** |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **冲孔→填孔→印刷→叠层→水压→脱脂烧结→后印→后烧→激光切割→成品检验** | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制/** | |  | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 重大环境因素：火灾，噪音排放，固废排放、能源消耗；  控制措施：集中集收外售至废品回收站；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。 | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | |  | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 中华人民共和国环保法、固体废物污染环境防治法、大气污染环境防治法，中华人民共和国安全生产法、劳动法、职业病防治法，电子陶瓷零件技术条件（GB9531.1-1988）、滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件GB/T15155-1994、电子陶瓷用氧化铝粉体材料GB/T15154-1994、厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片GB/T4619-2013、厚膜陶瓷基板生产工厂设计标准GB51333-2018等 | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 检验外观、规格、性能。 | | | | |
| **其它相关知识** | |  | | | | |

**填表人(专业人员)： 文波 日期： 2020.9.2 审核组长： 文波 日期：2020.9.2**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**